

# 2015年3月期 第2四半期(2014年4月～9月)

## 東京エレクトロン 決算説明会

内容:

➤ 第2四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 2015年3月期 事業環境および業績予想

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年10月29日



TOKYO ELECTRON

Corp IR/October 29, 2014

# 第2四半期連結決算の概要

---

取締役執行役員 原田 芳輝

2014年10月29日

# 業績サマリー

	2014年3月期		2015年3月期	対前年上期 増減	(億円)
	上期	下期	上期		(ご参考) 7/29発表の 2015年3月期 上期予想
売上高	2,545	3,576	2,942	+16%	2,900
売上総利益 <small>下段: 売上総利益率</small>	800 31.5%	1,218 34.1%	1,074 36.5%	+34%	
販管費	818	878	773	-6%	
営業利益 <small>下段: 営業利益率</small>	-18 -0.7%	340 9.5%	301 10.2%	+319億円	245 8.4%
税前利益	-3	-114	291	+294億円	220
当期純利益	24	-218	200	+175億円	155
研究開発費	384	402	349	-9%	
設備投資額	67	60	72	+8%	
減価償却実施額	127	121	97	-24%	

## 売上総利益率、営業利益率がともに前期より改善

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. 当期(2015年3月期)からEC/CN事業は連結対象外となりました。

# 部門別売上高

(億円)

	2014年3月期				2015年3月期		(ご参考) 7/29発表の 2015年3月期 上期予想
	上期		下期		上期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	
SPE	1,947	77%	2,840	80%	2,726	93%	2,700
FPD	93	4%	189	5%	190	6%	180
PVE	32	1%	5	0%	23	1%	20
EC/CN	467	18%	539	15%			
その他	2	0%	2	0%	2	0%	0
合計	2,545	100%	3,576	100%	2,942	100%	2,900

■ SPE  
(半導体製造装置)

DRAM向け売上が好調。地域別では米国・台湾が堅調な伸び。

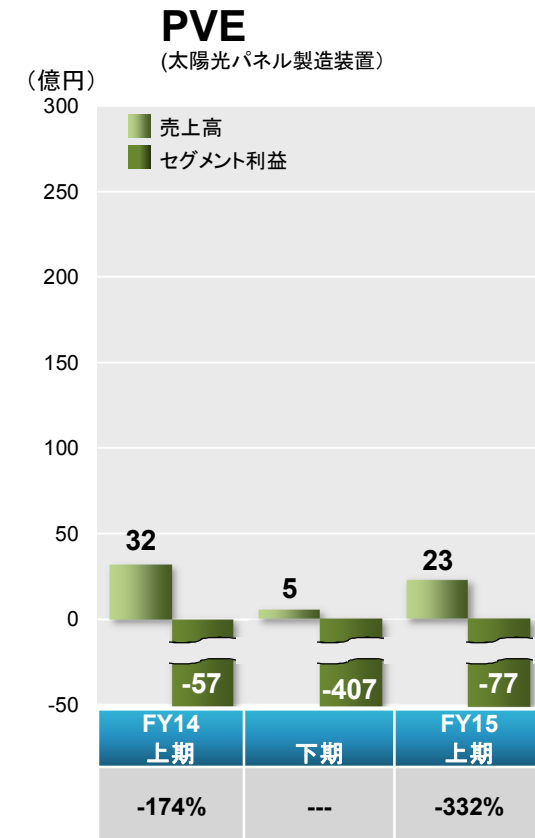
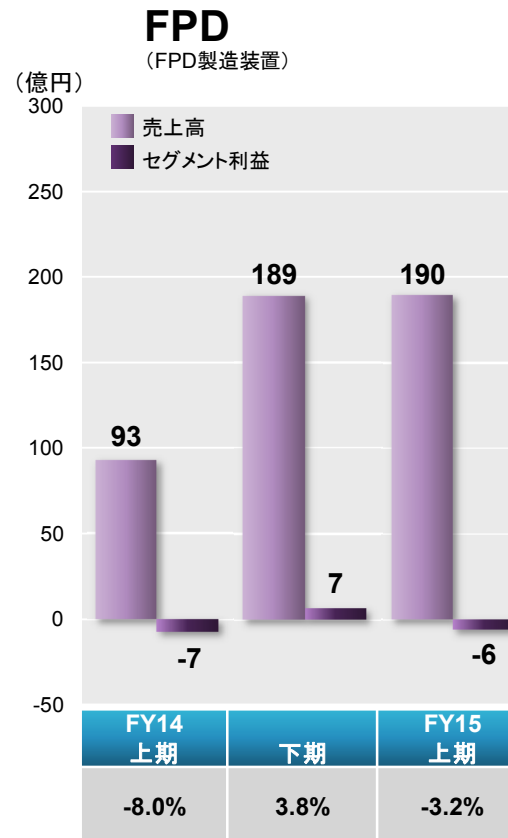
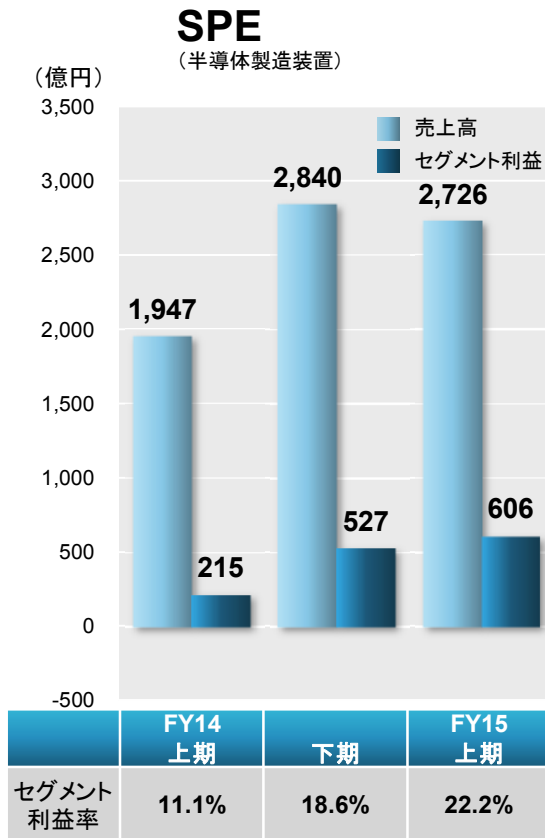
■ FPD  
(FPD製造装置)

中国向けの売上が中心。

■ PVE  
(太陽光パネル製造装置)

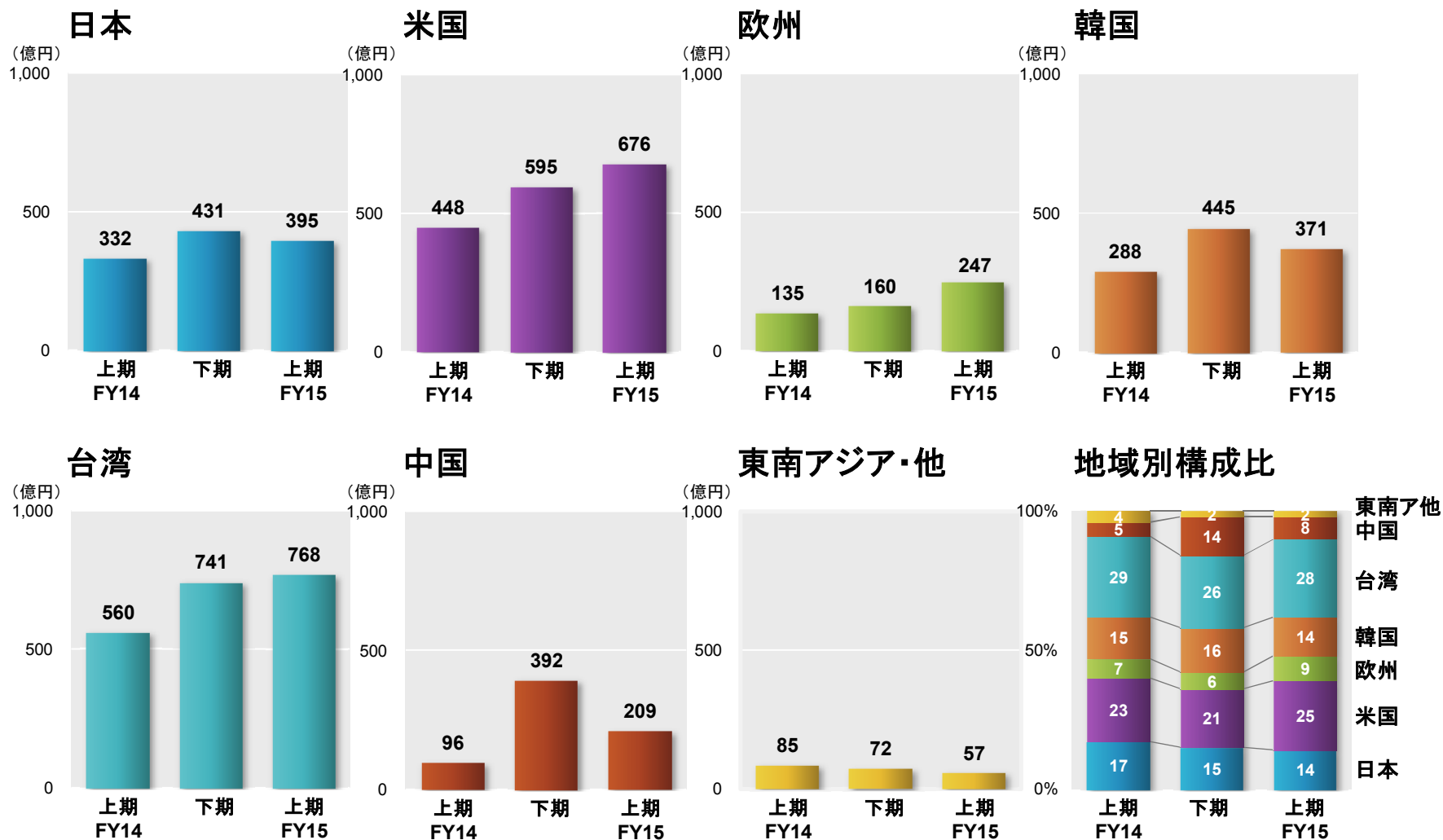
2014年3月末で製造開発および販売活動を終了。納入装置のサポートのみ継続。

# セグメント情報



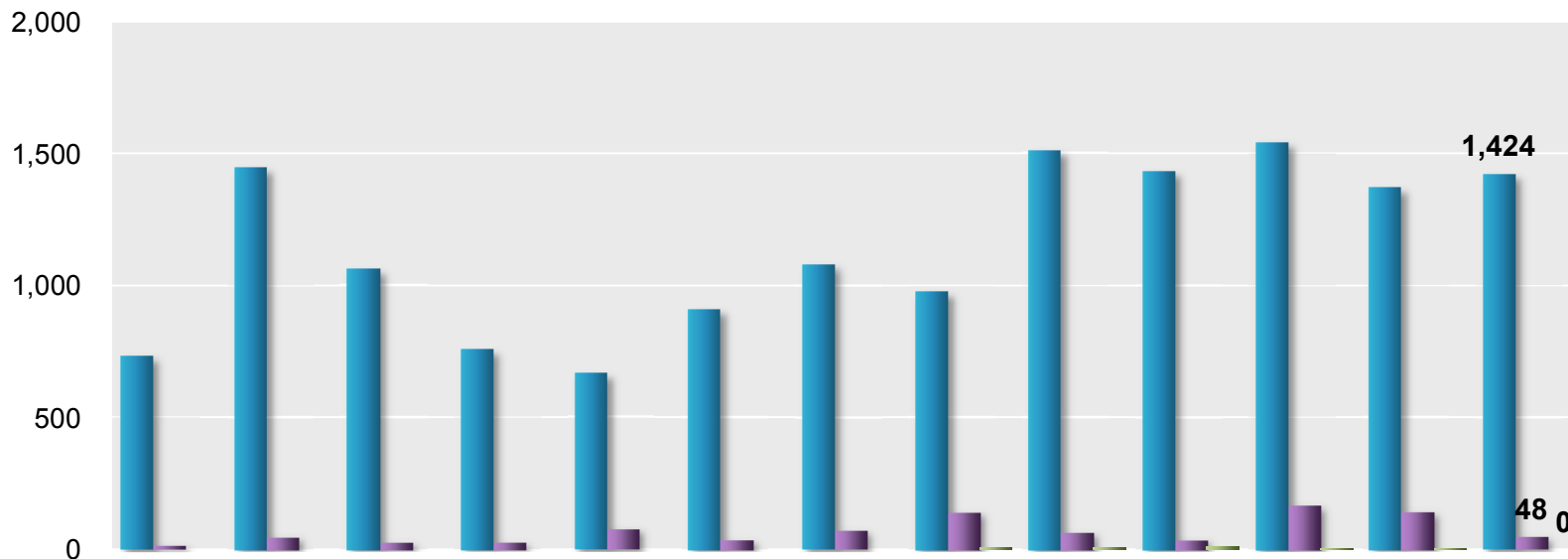
1. 従来のFPD/PVEセグメントを、FY14/1QよりFPDとPVEに分けて開示しています。
2. セグメント利益は、税前利益です。
3. 上記報告セグメントに配分していない全社費用があります。

# SPE部門地域別売上高



# 受注額・受注残高

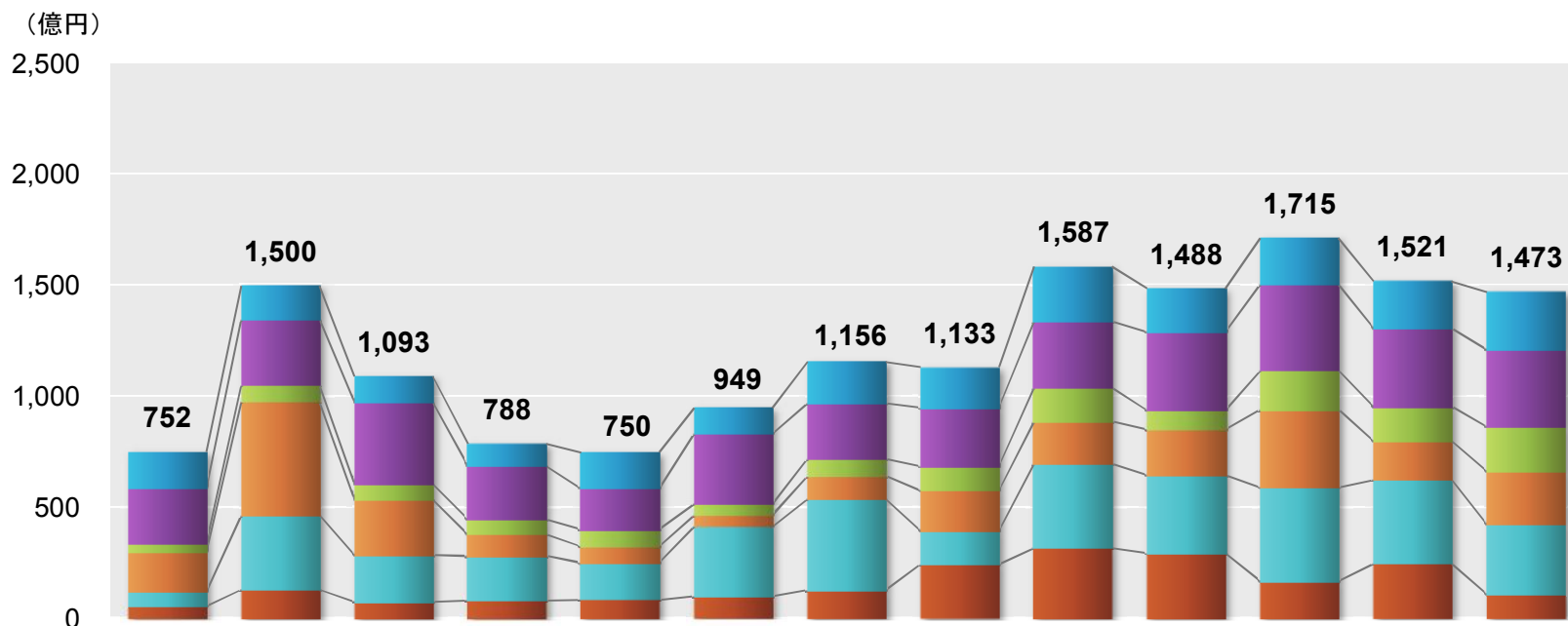
(億円)



	FY12 2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q	4Q	FY15 1Q	2Q
■ SPE受注額	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977	1,513	1,434	1,544	1,372	1,424
■ FPD受注額	17	50	28	27	80	36	73	144	63	38	166	142	48
■ PVE受注額				0	0	0	0	11	11	14	5	5	0
SPE受注残高	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,960	2,372	2,099	2,110	2,170
FPD受注残高	394	278	142	122	158	148	160	255	274	225	290	293	291
PVE受注残高				0	-	84	84	76	74	77	89	84	72

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

# 地域別受注額：SPE+FPD+PVE



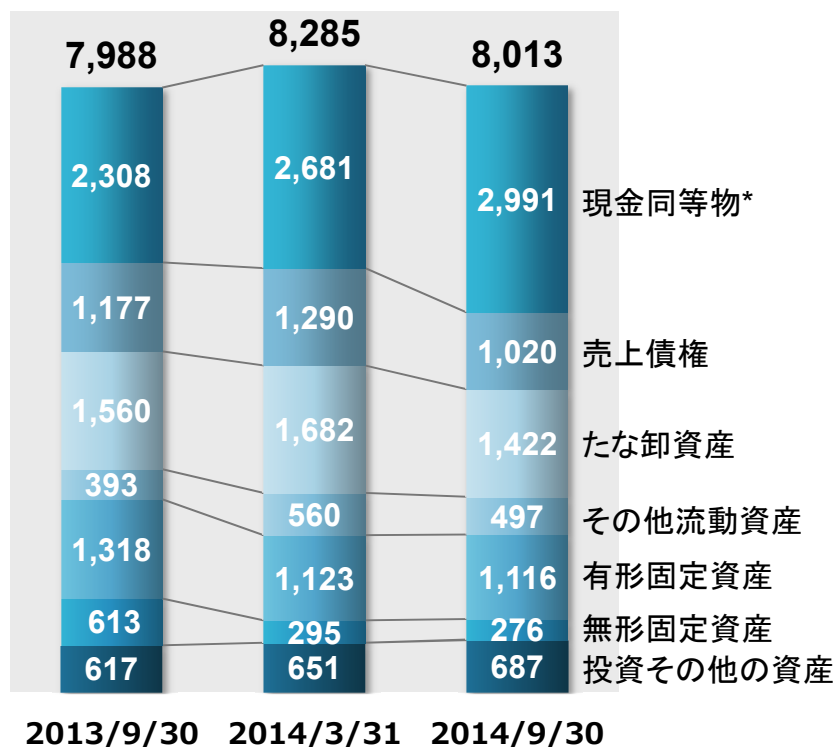
	FY12 2Q	FY12 3Q	FY12 4Q	FY13 1Q	FY13 2Q	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q	FY14 3Q	FY14 4Q	FY15 1Q	FY15 2Q
国内	163	149	117	100	163	115	187	183	247	196	209	212	259
米国	248	297	368	240	184	317	249	264	298	353	389	352	348
欧州	39	76	70	68	77	50	77	109	153	85	175	155	199
韓国	179	511	251	97	73	52	105	182	191	206	350	176	241
台湾	66	335	210	200	167	313	410	149	378	352	423	377	313
中国・東南ア他	54	129	74	81	83	100	127	244	317	293	167	246	110



# 貸借対照表

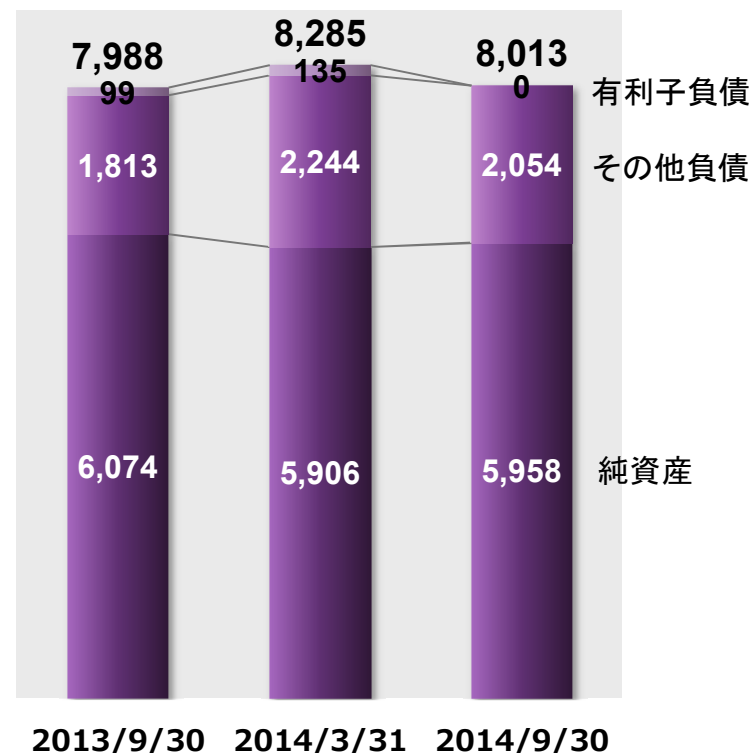
## 資産

(億円)



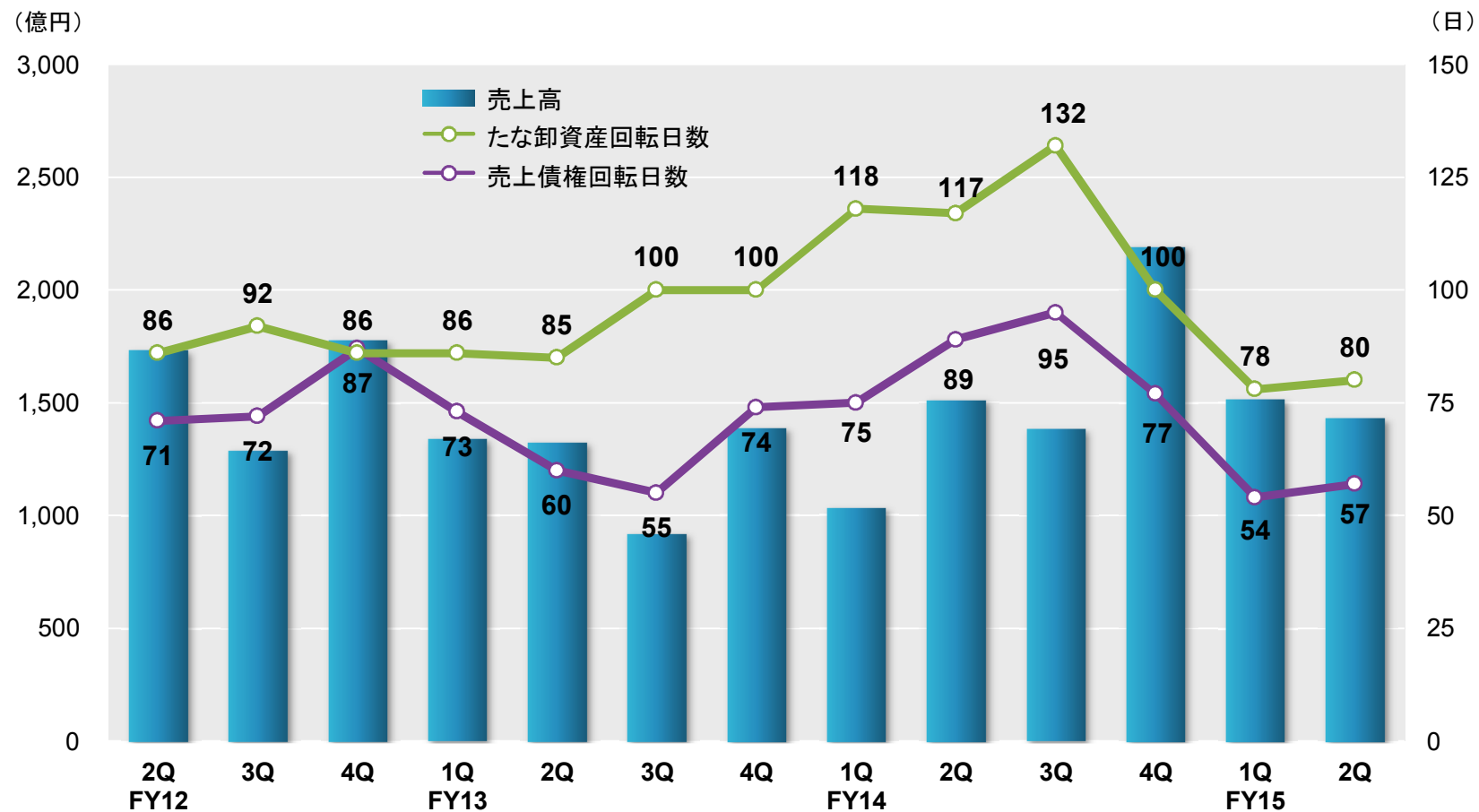
## 負債・純資産

(億円)



1. 現金同等物\*: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は有価証券)
2. 当期(2015年3月期)からEC/CN事業は連結対象外となりました。

# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

	2014年3月期 上期	2015年3月期 上期	(億円)
<b>営業キャッシュ・フロー</b>	<b>△2</b>	<b>433</b>	
税引前利益	△3	291	
減価償却費	127	97	
売上債権の減少(△増加)	△163	53	
たな卸資産の減少(△増加)	△203	51	
仕入債務の増加(△減少)	90	△65	
法人税等の支払額または還付額	3	△153	
その他	145	158	
<b>投資キャッシュ・フロー</b>	<b>71</b>	<b>853</b>	
設備投資	△52	△65	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却	-	17	
満期3ヵ月超の預金等の増減額	139	893	
その他	△15	9	
<b>財務キャッシュ・フロー</b>	<b>11</b>	<b>△64</b>	
配当金支払い	△46	△62	
その他	57	△1	
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>899</b>	<b>2,250</b>	
<b>満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高</b>	<b>1,408</b>	<b>740</b>	
<b>現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高</b>	<b>2,308</b>	<b>2,991</b>	

# 補足資料

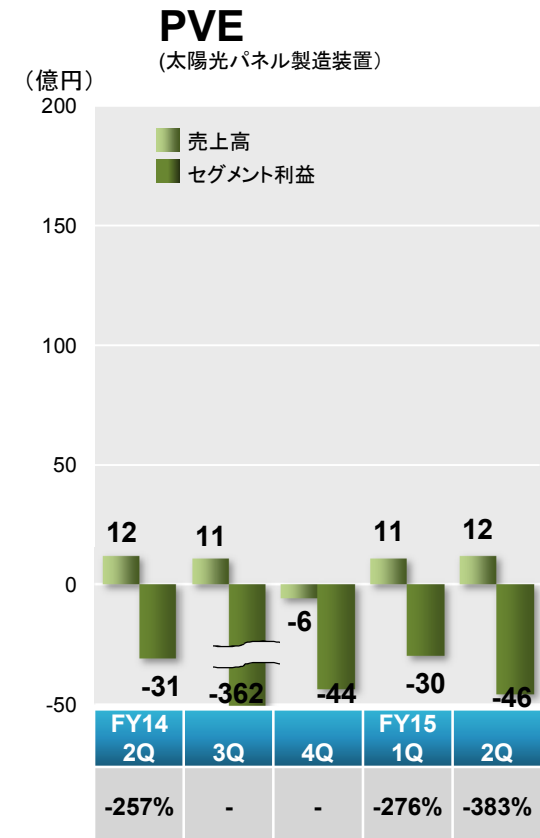
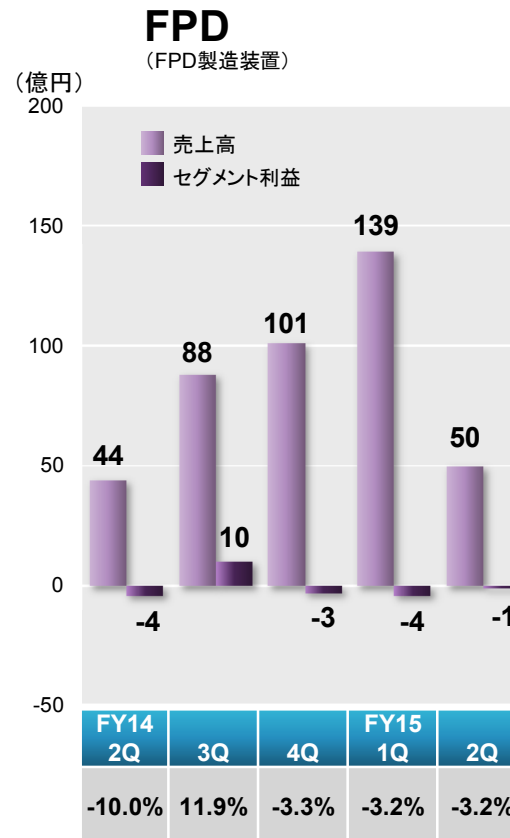
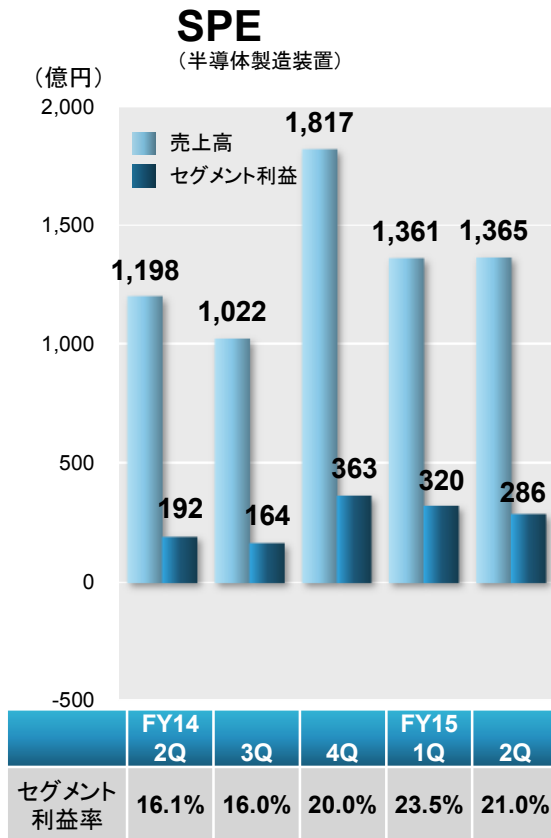


# 業績サマリー

	2014年3月期			2015年3月期		(億円)
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
<b>売上高</b>	<b>1,510</b>	<b>1,384</b>	<b>2,192</b>	<b>1,513</b>	<b>1,429</b>	
SPE	1,198	1,022	1,817	1,361	1,365	
FPD	44	88	101	139	50	
PVE	12	11	-6	11	12	
EC/CN	253	260	279			
その他	1	0	1	1	1	
<b>売上総利益</b>	<b>501</b>	<b>503</b>	<b>715</b>	<b>553</b>	<b>520</b>	
下段: 売上総利益率	33.2%	36.4%	32.6%	36.6%	36.4%	
<b>販管費</b>	<b>423</b>	<b>412</b>	<b>465</b>	<b>383</b>	<b>390</b>	
<b>営業利益</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>249</b>	<b>170</b>	<b>130</b>	
下段: 営業利益率	5.2%	6.6%	11.4%	11.3%	9.1%	
<b>税前利益</b>	<b>95</b>	<b>-372</b>	<b>257</b>	<b>150</b>	<b>140</b>	
<b>当期純利益</b>	<b>54</b>	<b>-380</b>	<b>162</b>	<b>118</b>	<b>81</b>	
研究開発費	204	189	212	167	181	
設備投資額	19	14	45	37	35	
減価償却実施額	64	58	62	47	50	

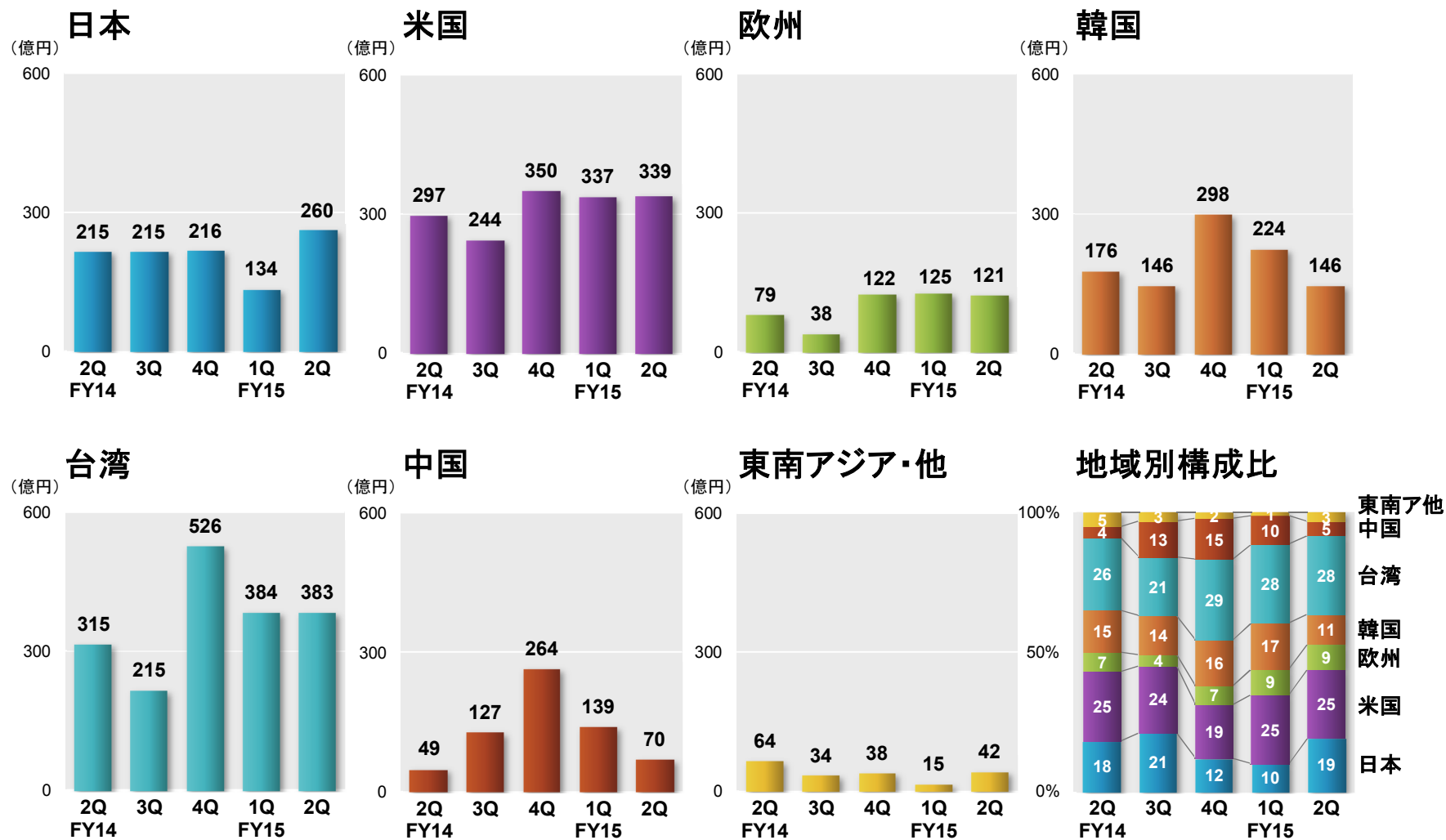
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

# セグメント情報



1. 従来のFPD/PVEセグメントを、FY14/1QよりFPDとPVEに分けて開示しています。
2. セグメント利益は、税前利益です。
3. 上記報告セグメントに配分していない全社費用があります。
4. PVEセグメントについては、FY14/4Qに工事進行基準売上高の進捗度を再精査しました。

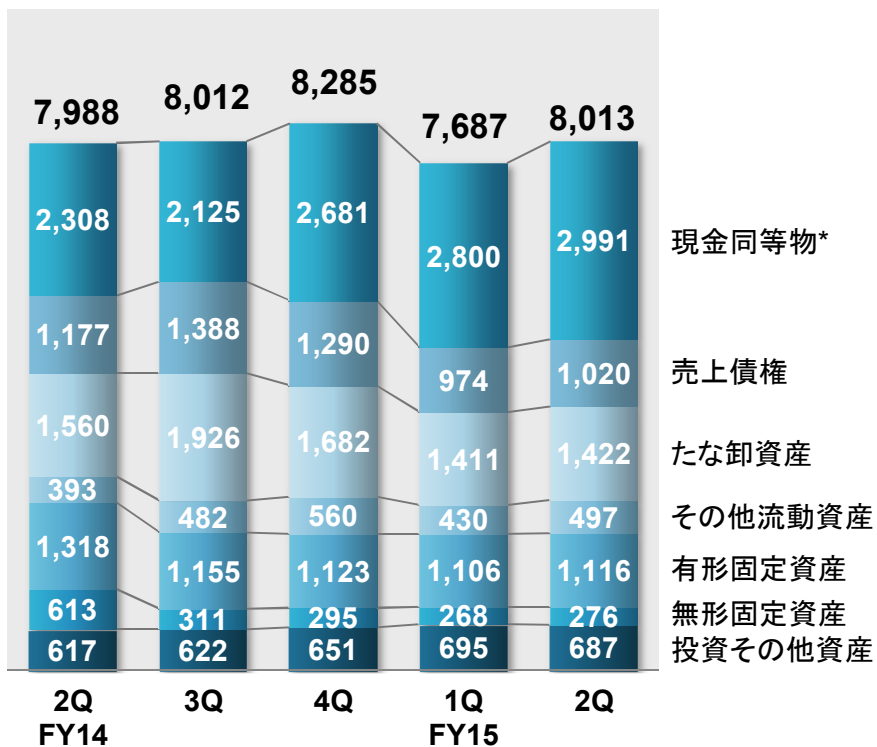
# SPE部門地域別売上高



# 貸借対照表

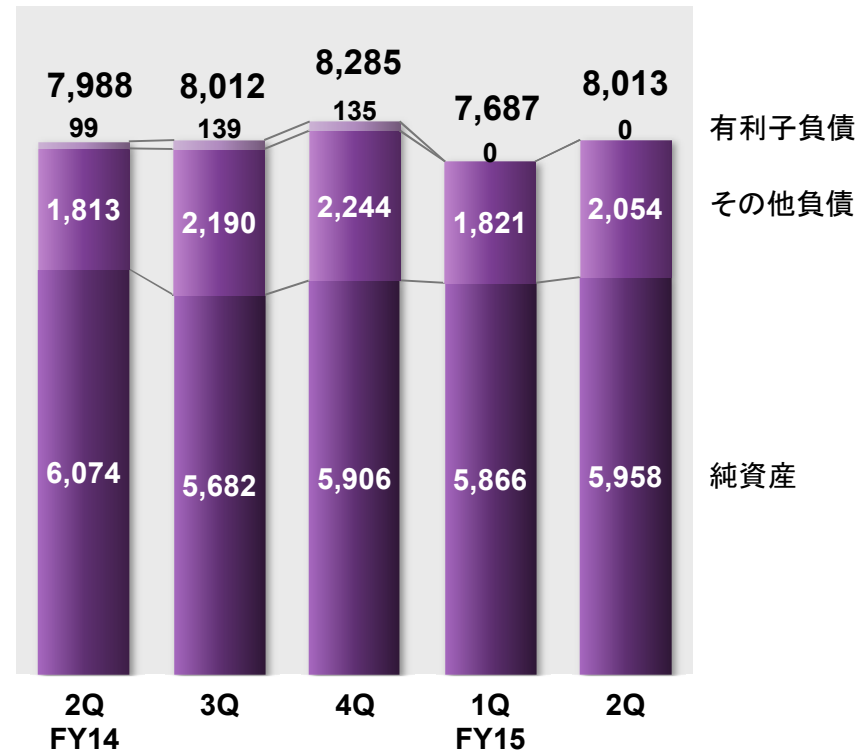
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

(億円)



1. 現金同等物\*: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は有価証券)
2. 当期(2015年3月期)からEC/CN事業は連結対象外となりました。



# 2015年3月期 事業環境および業績予想

---

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年10月29日



TOKYO ELECTRON

Corp IR/October 29, 2014

# 2015年3月期 事業環境



**TOKYO ELECTRON**

Corp IR/October 29, 2014

# 事業環境

---

## ▶ 半導体設備投資

CY2014の半導体前工程(WFE)の設備投資額は、前年比+15%前後の\$32B程度を見込む。

モバイル機器市場は台数ベースで対前年比+25%程度の成長が見込まれ、特にメモリ向け設備投資が拡大すると予測。

- DRAM/NAND: モバイル機器が引き続き需要を牽引し設備投資は拡大
- ファウンドリ: モバイル機器向け半導体設備投資は対前年比増加
- ロジック: PC市場は堅調に推移し、WFE設備投資は前年並み

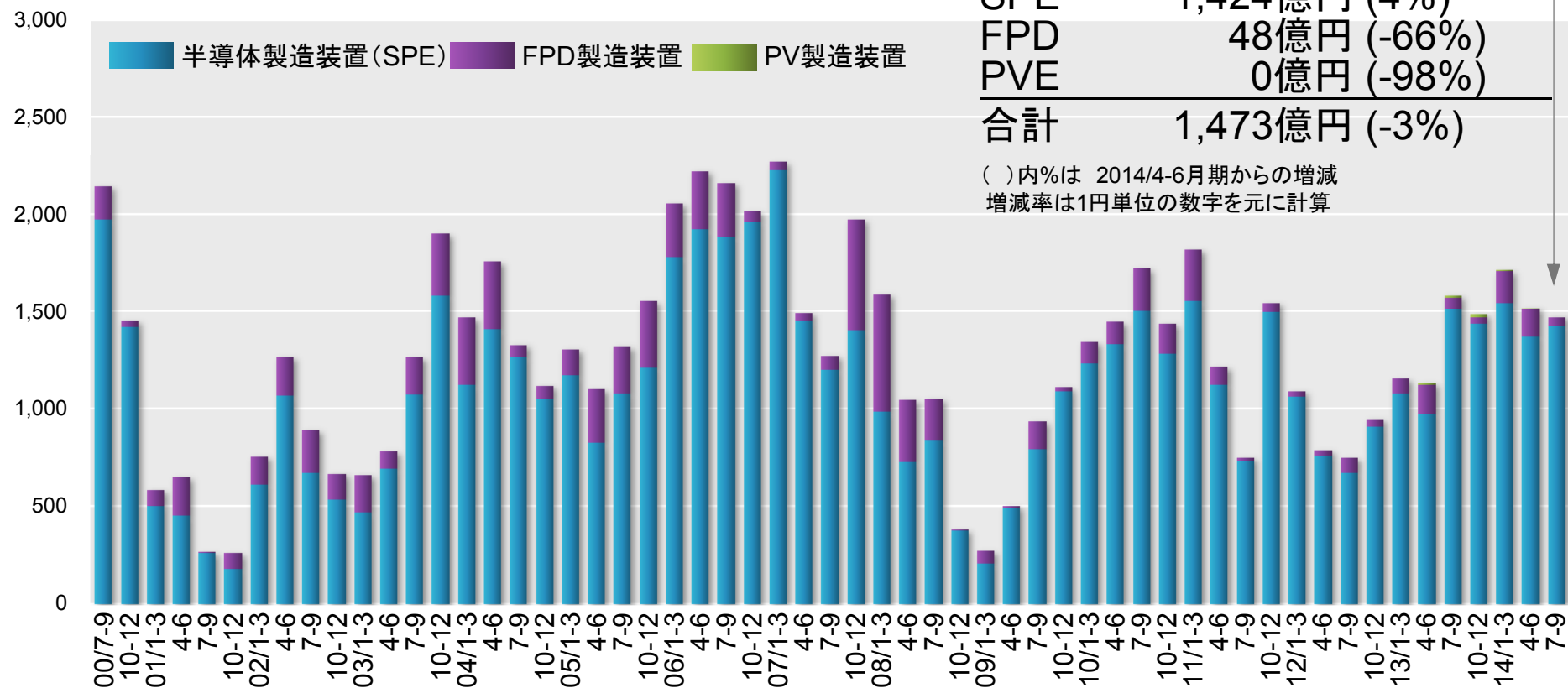
## ▶ FPD設備投資

CY2014の液晶パネル用製造装置の需要は、中国での大型パネル向け設備投資を中心に堅調。また、CY2015は、中小型パネル向け投資の増加が予想され、引き続き堅調な投資が見込まれる。有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降。

(2014年10月時点での見方)

# 四半期 受注額

(億円)



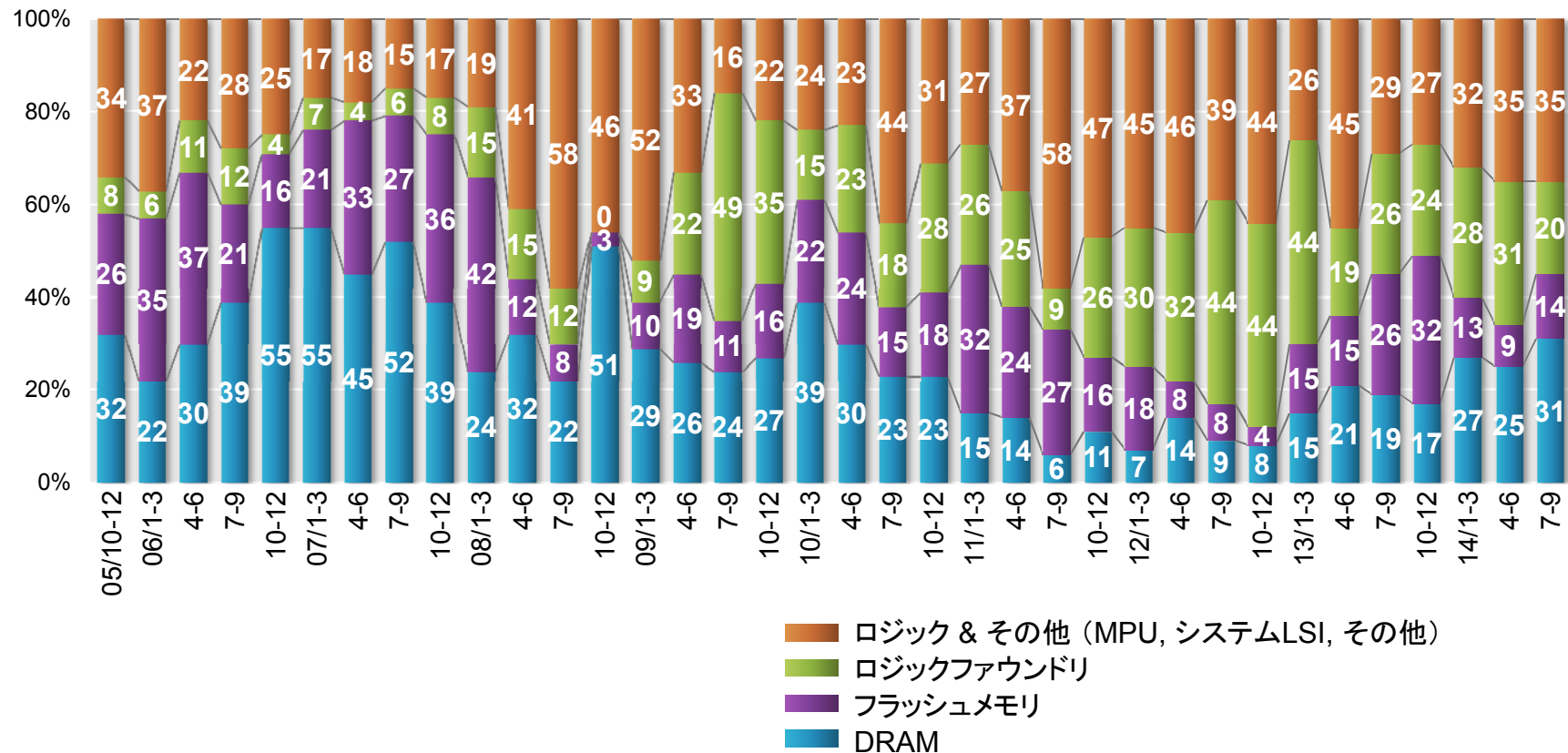
## 2014/7-9月期

SPE	1,424億円 (4%)
FPD	48億円 (-66%)
PVE	0億円 (-98%)
合計	1,473億円 (-3%)

( )内%は 2014/4-6月期からの増減  
増減率は1円単位の数字を元に計算

2012/1-3月期以前のPV製造装置の受注額は  
FPD製造装置の値に含まれています。

# アプリケーション別SPE受注額



グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

# 半導体設備投資の今後の見通し

- CY2014**
- ▶ DRAM/NAND微細化投資
  - ▶ 3D NAND投資開始
  - ▶ ファウンドリ20nm世代投資

電子機器および半導体市場の成長が継続し、  
半導体設備投資を牽引する

- CY2015**
- ▶ DRAM/NAND増産投資
  - ▶ 3D NAND投資増加
  - ▶ ファウンドリ1X世代投資開始

半導体設備投資は対前年比増加を見込む

# 2015年3月期 業績予想



**TOKYO ELECTRON**

Corp IR/October 29, 2014

# 2015年3月期 業績予想

▶ 収益性が向上、下期は上期比較で40%の増益を見込む

(億円)

	FY2014	FY2015				通期 対前年 増減
		上期	下期	通期		
		実績	予想 (参考情報)	予想 (参考情報)		
売上高	6,121	2,942	3,040	5,982	-2%	
SPE	4,788	2,726	2,850	5,577	+16%	
FPD	283	190	130	320	+13%	
PVE	38	23	60	83	-	
EC/CN*	1,007					
その他	4	2	-	2	-	
営業利益	322	301	430	731	+409	
下段: 営業利益率	5.3%	10.2%	14.2%	12.2%	+6.9pts	
税前利益	-117	291	-	-	-	
当期純利益	-194	200	-	-	-	

アプライド マテリアルズとの経営統合効力発生日が未定であるため、下期および通期の業績予想は参考情報です。

\*EC/CN事業を行っている東京エレクトロデバイスは、FY2015より当社の連結子会社から持分法適用会社となりました。

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置 PVE: 太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク



# 事業ハイライト(当期の進捗)

## ▶ 半導体製造装置事業

- コータ/デベロッパ: 欠陥対策機能を備えた高付加価値製品で高シェアを維持
- 熱処理成膜装置: セミバッチ式のALD成膜装置の顧客評価が進む
- エッチング装置: 堅調なロジック投資とメモリ向け工程増加でビジネス拡大
- 洗浄装置: 微細化に対応した製品展開が好調
- 枚葉成膜装置: メタル成膜装置の製品拡販が好調
- テストシステム: テスター一体型マルチセルテストシステムの顧客展開が順調

## ▶ FPD製造装置事業

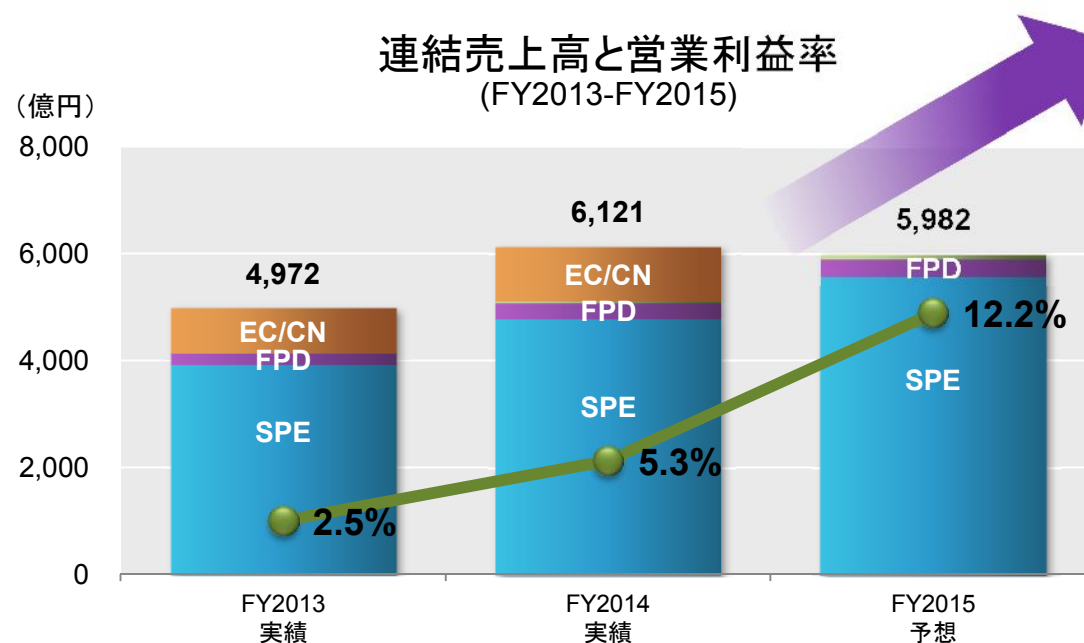
- G8向けICP\*エッチング装置で優位性を維持

CY2014 WFEシェアは13%程度を見込む

\*ICP: Inductively Coupled Plasma (誘導結合プラズマ)

# 利益成長の追求

- ▶ 高い競争力のある製品投入により、売上および収益性が向上
- ▶ 経営資源をSPE/FPD事業に集中



中期的に営業利益率25%以上を目指す

# アプライド マテリアルズとの経営統合に向けた進捗

- ▶ 各国当局による競争法の審査は継続中
- ▶ 事業運営の統合準備は、お互いの企業文化の強みを融合し、一つの会社となるべく、順調に進展。



統合完了は2014年内を目指す  
が、2015年1-3月期になる可能性もある

## まとめ

---

1. CY2014 WFEは、前年比15%の増加を見込む。モバイル機器に牽引され、メモリ、ファウンドリ顧客の投資意欲は旺盛
2. SPE/FPD事業に経営資源を集中、競争力のある製品投入により、利益成長を目指す。
3. アプライド マテリアルズとの統合完了は、2014年内を目指す

---

## ▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

## ▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

## ▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

